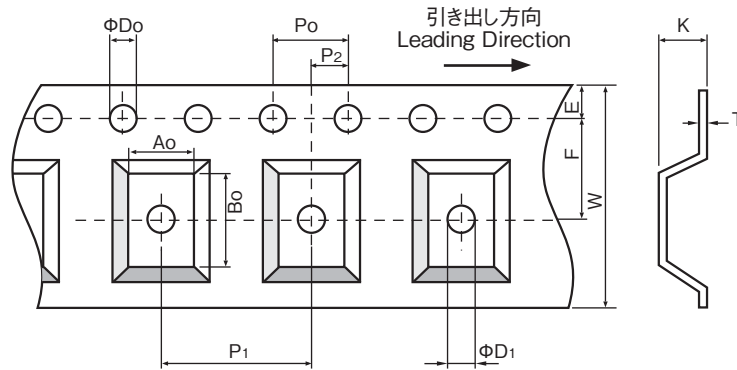
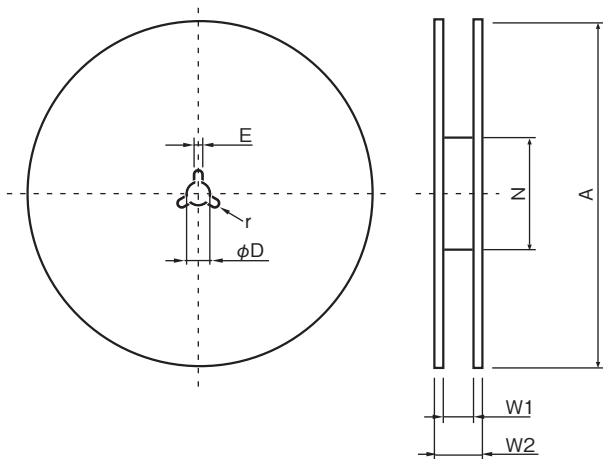


◆ キャリアテープ寸法 / CARRIER TAPE DIMENSIONS



チップサイズ Chip size	コード Taping code	寸法 Dimensions [mm]											
		A0 ±0.1	B0 ±0.1	W ±0.2	F ±0.05	E ±0.1	P1 ±0.1	P2 ±0.05	Po ±0.1	φD0 ±0.1	φD1 +0.2/-0	K ±0.1	T ±0.05
1608	Y 1	1.1	1.9	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	1.5	—	0.8	0.20
2012	Z 1	1.45	2.25	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	1.5	1.0	1.0	0.25
	Z 2											1.3	0.25
3216 1632	A 1	1.9	3.5	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	1.5	1.1	1.4	0.30
	A 2											1.8	0.30
3225	B 1	2.8	3.5	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	1.5	1.0	1.8	0.30
	B 2											2.2	0.30
	B 3											2.4	0.30
4532 3245	C 1	3.6	4.9	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	1.5	1.5	1.8	0.30
	C 2											2.2	0.30
	C 3											2.4	0.30
	C 4											3.0	0.30
5750	D 1	5.3	6.0	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	1.5	1.6	2.2	0.30
	D 2											2.6	0.30
	D 3											3.0	0.30

◆ リール寸法 / REEL DIMENSIONS

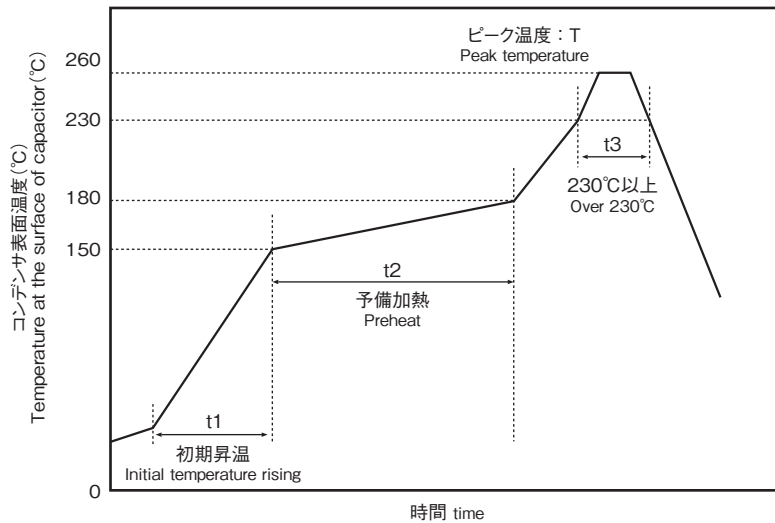


製品寸法 Chip size	テーピングコード Taping code	リールサイズ Reel size	包装数量 Quantity
1608	Y1	φ180mm	4,000pcs/reel
2012	Z1, Z2	φ180mm	3,000pcs/reel
3216 1632	A1	φ180mm	3,000pcs/reel
	A2	φ180mm	2,000pcs/reel
3225	B1, B2, B3	φ180mm	2,000pcs/reel
4532 3245	C1, C2	φ180mm	1,000pcs/reel
	C3, C4	φ180mm	500pcs/reel
5750	D1, D2	φ180mm	1,000pcs/reel
	D3, D4	φ180mm	500pcs/reel

テーピングコード Taping code	寸法 Dimensions [mm]						
	A ±1.0	N ±1.0	W1 ±1.0	W2 ±1.0	φD ±0.2	E ±0.5	r ±0.2
Y, Z, A, B	180	60	9.5	13.1	13.0	2.0	1.0
C, D	180	60	13.5	18.5	13.0	2.0	1.0

● 基板実装条件 / SOLDERING CONDITIONS

◆ リフロー条件 / REFLOW SOLDERING CONDITIONS **MU series/MS series/MR series/ST series**



初期昇温区間: t1 Period of initial temperature rising	予備加熱区間: t2 Period of preheat	230°C以上区間: t3 Period over 230°C	ピーク温度: T Peak temperature
常温 (room temperature) ~150°C 3°C/ sec MAX	150~180°C 60~120 sec	30~60 sec	260°C MAX

※温度測定位置は、コンデンサ積層体表面とする。Temperature is measured at the surface of capacitor.

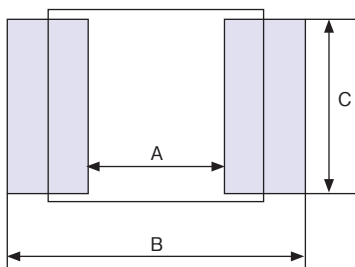
- 1) ピーク温度での滞留は極力短くしてください。
Holding time at the peak temperature should be as short as possible.
- 2) リフローの繰り返し回数は2回までとし、2回目のリフローはコンデンサ温度が常温に戻ってから行ってください。
Reflow soldering cycle is limited to two (2). The second soldering should be done after the capacitor itself has returned to room temperature.
- 3) 推奨温度プロファイルとは異なる条件でリフロー実装を行う場合には、事前にお問い合わせください。
Please consult us in advance if your reflow soldering condition is different from recommended condition.

◆ フロー条件 / FLOW SOLDERING CONDITIONS **MU series/MS series/MR series/LDT series**

フロー条件についてはお問い合わせください。
Please consult us about flow soldering conditions.

◆ 推奨ランドパターン / RECOMMENDED LAND SIZE **MU series/MS series/MR series/ST series**

コンデンサ実装用のランド寸法は、極力下表の設計値をご使用ください。
但し、フロー実装の場合にはB寸法を下表よりも0.4~0.6mm程度大きくしてください。
ランド設計値が推奨値と大幅に異なる場合は、事前にお問い合わせください。
For designing land size, refer to the following recommended land size.
However, in flow soldering, please enlarge B dimension about 0.4 to 0.6 mm.
Please consult us in advance if your land desing is vastly different from recommended land size.



チップ形状 Chip size	ランド寸法記号 (mm) Dimensions		
	A	B	C
1608	0.5	2.0	0.7
2012	0.8	2.4	1.1
3216	1.8	3.6	1.4
3225	1.8	3.6	2.3
4532	2.7	5.7	3.0
5750	3.5	7.8	4.5
1632	0.5	2.2	3.0
3245	1.8	3.6	4.1